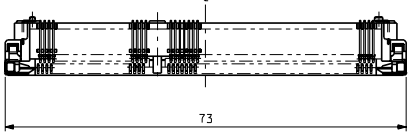
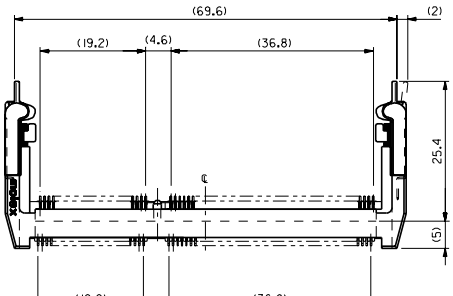
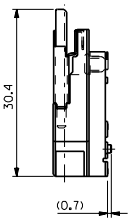
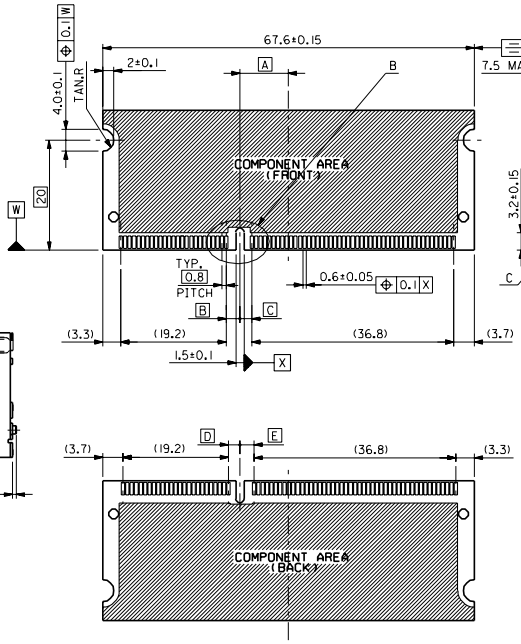
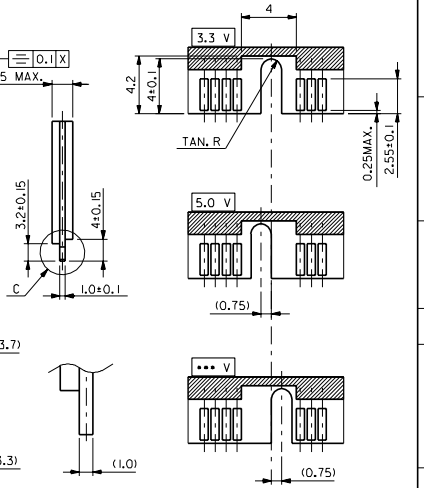








推奨基板寸法
RECOMMENDED MATING BOARD CONFIGURATION
(THK:1.0±0.1)

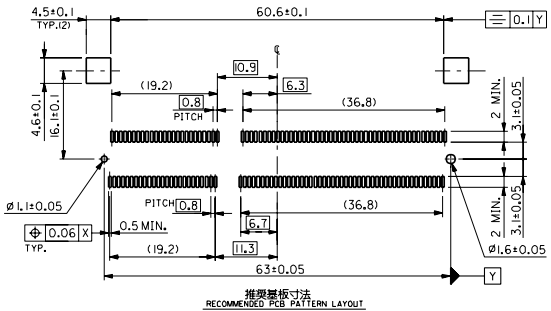


注記 NOTES.

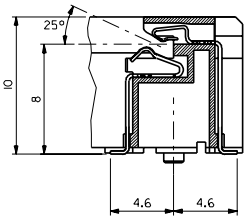
1. 材料 MATERIAL
ハウジング ： ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING : G.F. LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル ： 燐青銅
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
ネイル ： 黄銅
NAIL : BRASS
ラッチカバー ： ステンレス鋼
LATCH COVER : STAINLESS STEEL

2. めっき仕様 PLATING
ターミナル
TERMINAL
接点部 ：金めっき 0.25μmMIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部：半田めっき 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN-LEAD 1.0μmMIN.
下地めっき：ニッケルめっき2.0μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 2.0μmMIN.
ネイル
NAIL
半田めっき：2.0μmMIN.
TIN-LEAD : 2.0μmMIN.

3. テール平坦度は、0.1 MAX.
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(THK:1.2±0.1)



SECTION A-A
(SCALE: 5-1)

1.75	2.85	1.35	3.25	8.05	••• V	ハードトレイ HARD TRAY	54189-1445
						標準トレー NORMAL TRAY	54189-1442
3.25	1.35	2.85	1.75	9.55	5.0V	ハードトレイ HARD TRAY	54189-1444
						標準トレー NORMAL TRAY	54189-1441
2.5	2.1	2.1	2.5	8.8	3.3V	ハードトレイ HARD TRAY	54189-1443
						標準トレー NORMAL TRAY	54189-1440
E	D	C	B	A	POWER SUPPLY	梱包トレー PACKAGING TRAY	ENG.NO.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
B	変更 REVISED (JD8-1494)		'98-04-29
A	変更 REVISED (JD8-1512)		'98-03-23
0	新規作成 RELEASED (JD7-2811)		'97-04-15

材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH 注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE —
被覆外径 INS. RANGE —
DRAWN BY
CHK'D BY
APP'D BY
尺度 SCALE 2-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
SGRAM
0.8mm PITCH S.O.DIMM
HS'G ASS'Y 144CKT. (H=10)

DWG. NO. SD-54189-144*
REV B

DWG. NO. SD-54189-144*

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ZF-34 10.02.23 SD-54189-1.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁じる。

EN-01C(032)MXJ-31

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor